

广发证券股份有限公司

关于

深圳市艺感科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书



二零二六年五月

## 声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《深圳市艺感科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。

## 目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
<b>第一节 本次证券发行基本情况 .....</b>	<b>3</b>
一、发行人基本情况 .....	3
二、本次证券发行的基本情况 .....	17
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 .....	18
四、发行人与保荐人的关联关系 .....	19
<b>第二节 保荐机构的承诺事项 .....</b>	<b>20</b>
本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对 发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发 行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。 .....	20
二、本保荐机构自愿接受深圳证券交易所的自律监管。 .....	20
<b>第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 .....</b>	<b>21</b>
一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 .....	21
二、本次证券发行上市所履行的程序 .....	21
三、发行人符合板块定位及国家产业政策的核查情况 .....	22
四、本次发行符合上市条件 .....	26
五、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 .....	30
六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 .....	31
七、保荐机构认为应当说明的其他事项 .....	31

## 第一节 本次证券发行基本情况

### 一、发行人基本情况

#### (一) 发行人基本信息

公司名称	深圳市艺感科技股份有限公司
英文名称	Shenzhen Topsun Technology Co., Ltd.
法定代表人	田林
注册资本	5,000 万元
成立日期	2007 年 12 月 2 日
注册地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航空路华丰智谷-航城高科技产业园 B 座 1 层
办公地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航空路华丰智谷-航城高科技产业园 B 座 1 层
联系人	钟辉
邮政编码	518126
互联网网址	www.sztopsun.com
电话	0755-27800416
电子邮箱	ir@sztopsun.com
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
经营范围	新型电子元器件，声学设备，集成电路，印刷电路板，连接器，散热片及电脑周边设备的销售；通讯器材、计算机、软件、网络设备的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律，行政法规禁止的项目除外；法律，行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）电子元器件制造。

#### (二) 发行人的主营业务

公司主要从事高特性功率电感元器件的研发、生产与销售，深耕高性能芯片核心供电模块（VRM）应用，向全球知名品牌商、制造服务商提供具有高效率低损耗、高饱和电流、高瞬态响应、高可靠性、小型化、薄型化、集成化等特性的功率电感产品解决方案。公司主营高特性功率电感为 VRM 模块的关键元器件，其核心作用包括能量传递、电流平滑续流、抑制电流突变/尖峰、降低纹波与噪声等，以充分满足高性能芯片超低压、大电流、高瞬态等供电要求，其质量和特性直接关系到 VRM 电路的效率、电压稳定性、瞬态响应能力及可靠性，直接影

响高性能芯片的性能释放、响应效率与工作稳定性，并对整机的效能和稳定性产生重要影响，已成为支撑高性能芯片稳定高效运行的“隐形基石”。

经过长期耕耘和发展，公司已经拥有了高素质的技术产品开发团队以及较强的研发创新能力，不断在材料配方、生产工艺、产品结构设计等方面进行创新开发，积累了众多全球知名品牌商、制造服务商在内的优质客户资源。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已取得专利 105 项，其中发明专利 17 项。公司已掌握一体成型功率电感冷压、热压及铜铁共烧等生产工艺，针对前沿应用领域推出 AI PC 小型化功率电感、多相结构功率电感、超薄型功率电感、立式结构功率电感、耦合结构功率电感、TLVR 功率电感、模组化结构功率电感等新产品，产品的研发与迭代符合新技术、新产业的发展趋势，公司已具备行业前沿功率电感的研发与交付能力。

### **（三）发行人的核心技术与研发水平**

#### **1、发行人的核心技术情况**

序号	类型	技术名称	技术先进性及特点	应用产品	相关专利	所处阶段	技术来源
1	材料配方与加工	粉末表面处理技术	通过长期试验研究与交付实践,成功开发出对应不同粉料材质的多种表面处理用复合钝化液,在独特的环境条件下,对粉料进行前加工处理,以使粉末表面形成薄而致密的钝化绝缘膜,且在高温高压的状况下仍可维持优异的绝缘性能。	一体成型功率电感	2019113669454 一种生产一体成型电感用羰基铁粉防锈粉末的制备方法 2025100894873 一种铁硅铬合金软磁粉芯及其制备方法 2024116762028 一种高绝缘高可靠性金属软磁粉芯及其制备方法	量产	自主研发
2		粉末颗粒级配技术	通过仿真模拟与试验,公司已成功开发出多种材质和不同磁导率适用的粉料级配配方,将不同材质/粒径的粉末按配方进行级配,达成更高的堆积密度,实现高磁导率,提升粉料饱和性能并降低粉料磁损。	一体成型功率电感	2019113698936 一种生产一体成型电感用低损耗粉末的制备方法	量产	自主研发
3		粉末造粒技术	通过对级配粉料的交联改性及多级雾化造粒工艺,使微细颗粒分散均匀、避免团聚,同时形成以大颗粒为核,小颗粒均匀吸附于表面的核壳结构,该技术可增强粉末颗粒与绝缘包覆介质的结合力并增加粉料的流动性、均一性。	一体成型功率电感	2019113698936 一种生产一体成型电感用低损耗粉末的制备方法 2024116762028 一种高绝缘高可靠性金属软磁粉芯及其制备方法	量产	自主研发
4		粉体绝缘技术	对表面处理后的粉料,通过有机或无机包覆的方式,形成高绝缘、高耐热的粉料包覆层,该技术可有效降低粉料微颗粒间的涡流损耗,提升电感的电气性能和效率。	一体成型功率电感	2019113698936 一种生产一体成型电感用低损耗粉末的制备方法 2019113669454 一种生产一体成型电感用羰基铁粉防锈粉末的制备方法 2025100894873 一种铁硅铬合金软磁粉芯及其制备方法	量产	自主研发
5	结构设计	多嵌槽结构设计技术	电感器于电路板 SMT 贴装过程中可能产生锡珠问题,导致外观不良、可靠性下降或短路问题。通过创新性的多嵌槽结构设计,搭配经配方与加工后的粉料,可实现一体成型电感引脚平面度的高度一致,提升电感引脚与电路板接触可靠性。多嵌槽结构设计及优化的倒角工艺,能够有效改善 SMT 贴装中的锡珠问题。该技术主要应用于高端显卡、AI 算力卡的高性能低损耗电感。	一体成型功率电感	2023117193759 电感器的热压成型方法 US12119169B1 HOT PRESS MOLDING METHOD FOR INDUCTOR 2024204545798 一种贴片电感的电极结构	量产	自主研发

序号	类型	技术名称	技术先进性及特点	应用产品	相关专利	所处阶段	技术来源
6		组装式低噪电感设计技术	低噪电感由磁罩、磁芯、特殊缓冲涂层、贴装式料片经过特殊封胶工艺设计而成，该设计结构可对电感器工作于高频开关状态下产生的磁芯磁致伸缩力和料片机械振动力进行隔离与吸收，抑制了其向周围结构及空气中的振动传递，达到噪声控制效果。	组装式功率电感	2025101349215 一种低噪音组装式贴片电感及其制备方法	量产	自主研发
7		大电流组装式电感设计技术	大电流组装式功率电感由高饱和的磁罩、磁芯、低电阻的线圈构成，经过创新组装结构设计，再与结构相匹配的自动化上料与点胶工艺将其固定连接。电感器具有优异的饱和与温升电流、损耗小，具有高可靠性，主要应用于VRM电路，为高性能芯片提供稳定的电流。	组装式功率电感	2022215750250 一种大电流贴片电感 2022215597833 一种插件式电感	量产	自主研发
8		集成式电感成型技术	通过多线圈组合式成型电感的创新结构与工艺方案，分区集成实现多线圈模块化的均匀布局，显著提升空间利用率，实现高功密高性能的多集成式电感。搭配梯形引脚镀层技术增强机械稳定性和焊锡引流能力。应用产品适用于高频、高功率设备板卡，兼具小型化和高可靠性。	一体成型功率电感	2024222591794 一种多线圈组合式成型电感	量产	自主研发
9		耦合电感设计技术	利用创新设计结构线圈，结合经绝缘包覆的高性能、低损耗、高频应用粉末，形成高耐压、高性能的耦合电感器件，达到双相快速响应的效果，在有限空间内提升电感性能，满足高功率场景的需求。	一体成型功率电感	202410940128X 一种耦合电感器及其制作方法	试制	自主研发
10		可变电极结构技术	该技术在保证模组体积最小化的前提下，通过优化电极的布局与尺寸，实现了电极设计的多元化，并确保了内部结构的压制密度均匀一致，该技术可应用于前沿的模组化结构功率电感产品，可应用于垂直供电体系终端设备板卡。	一体成型功率电感	保密技术	试制	自主研发
11	工艺设备	冷压一体成型技术	采用新式的成型方式，绕线后在线圈中间增加具有一定密度的铁芯，然后再进行粉末压制。该成型方式成型产品中间密度高，没有裂纹，可改善旧有制程产品中间开裂问题，能够提升产品的整体感值和饱和性能。	一体成型功率电感	2019220053156 一种线圈内嵌型一体式复合电感	量产	自主研发

序号	类型	技术名称	技术先进性及特点	应用产品	相关专利	所处阶段	技术来源
12		热压一体成型技术	传统的热压工艺一般一个模穴成型一颗电感，产品压制效率低，同时由于产品尺寸特别小，容易造成粉末填充均匀度较差，特性无法发挥到最佳，且易造成模具损坏。采用新的集成阵列式热压工艺可实现单模穴多颗产品的压制，提升整体的作业效率，填粉精度更高，产品特性稳定性更佳。	一体成型功率电感	保密技术	量产	自主研发
13		高温热处理技术	根据不同的粉料配方，调整和控制热处理温度曲线，选择不同的保护/还原气氛及混合浓度比例，对成型后的器件进行高温热处理，该技术可消除胚体微颗粒间及与料片之间的内应力，提升产品致密度，有效提高粉料磁导率，降低高频磁损。	一体成型功率电感	2024116762028 一种高绝缘高可靠性金属软磁粉芯及其制备方法	小批量	自主研发
14		含浸工艺技术	选取性状稳定的超渗透浸渍材料，结合定制含浸设备，精确控制时间节点及后固化工艺参数，渗溶填充热处理后电感胚体内微气隙/毛细孔，增强电感机械强度，同时减少微气隙/毛细孔受内外温湿环境等因素影响，减少产品特性指标波动，有效降低高频损耗，提升电感电磁性能。	一体成型功率电感	保密技术	量产	自主研发
15		分级压制工艺技术	该技术根据粉料的性能进行逐层组合再进行压制，既可解决高性能铁粉在常规压制工艺下的产品开裂、破皮、脱模困难等问题，又可以优化产品的成本结构。	一体成型功率电感	保密技术	量产	自主研发
16		高精度一体成型电感自动化设备开发技术	该技术用于定制化开发具有工业自动控制系统和运动控制功能的一体化设备，该设备通过伺服模组加装真空机吸盘，将线圈经高速振动盘筛选后精准放入模具型腔内，利用伺服送粉机构实现精准填粉，伺服压机智能控制系统精准控制压力、位置、时间，完成线圈与粉末紧密压制成型，产品一致性高，生产效率高，生产过程清晰可控，能够较好满足高品质一体成型电感的自动化批量生产。	一体成型功率电感	保密技术	量产	自主研发

序号	类型	技术名称	技术先进性及特点	应用产品	相关专利	所处阶段	技术来源
17		多系列点焊裁切通用设备开发技术	通过对相关轨道进行变距设计，将模具进行拆分多级处理，搭配浮动配合设计，成功开发出对应不同产品系列的通用型点焊裁切一体机，实现机台共用和快速切换；同时降低不同系列切换产生的模具配件费用。	一体成型功率电感	2024113280930 一种多用途绕点一体装置	量产	自主研发

## 2、发行人的研发水平情况

公司不断努力提高自身产品的质量和技术水平，根据前瞻产业布局与客户及市场需求进行技术研究和产品开发。

### (1) 公司正在从事的研发项目具体情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人主要在研项目具体情况如下：

序号	项目	项目描述	项目拟达到目标
1	一体成型防开裂研发项目	因粉末颗粒间的摩擦、树脂固化收缩等因素，一体成型电感在成型与固化过程中产生的内应力可能超过了材料的结合强度，导致功率电感存在开裂情形，影响产品良率与可靠性。	通过材料配方、成型工艺参数的持续探索，结合创新的固化等工艺手段改善一体成型功率电感开裂现象。
2	一体成型提升饱和研发项目	提升一体成型电感的饱和电流特性是一个多维度、系统性的工程，其核心目标是提高电感在直流偏置下保持感值的能力，配方、工艺都是提升饱和特性的重要环节，为适应 GPU 功耗持续提升，拟通过材料和工艺的进一步探索，在合理成本下提升规模化量产软磁合金类一体成型功率电感产品的饱和性能。	通过材料配方、成型工艺参数的持续探索，进一步提升量产软磁合金类一体成型功率电感的饱和特性。
3	一种一体成型电感应超高磁导率低损耗合金粉料及制备方法研发项目	基于软磁合金粉料硬度较大，难以在常规成型条件和压力下实现高压制密实度，从而难以兼具绝缘特性、耐压特性及高磁导率。通过粉料前处理、胶黏剂调整、混合造粒工艺的优化等工艺，拟开发出一种在常规工艺条件下高磁导率合金粉料，以用于前沿应用场景，此外高磁导率磁芯可以有效减少绕线圈数，降低绕线电阻和一体成型电感的铜损。	通过粉料加工工艺及配方改进，拟开发合理成本下的高磁导率粉料配方。
4	高功率磁粉芯 TLVR 产品研发项目	算力服务器 VRM 负载呈现高频、高瞬态 $di/dt$ （电流变化率）的“尖峰”特性，传统方案的响应速度完全无法满足，会导致核心电压剧烈波动，影响算力稳定性和芯片寿命。TLVR（Trans-Inductor Voltage Regulators）将每相的功率电感替换为一个变压器（即“跨电感”），该变压器的初级绕组作为该相的功率电感，次级绕组则全部串联起来，形成一个闭合回路并在回路中串联一个补偿电感。负载瞬变发生时，不仅正在导通的相位进行输出，所有其他相也通过磁耦合进入响应过程，使得系统的等效瞬态电感远小于单相电感，从而将整体输出电流的变化率提升数倍。TLVR 是目前应对低电压大电流应用中快速负载波动的新一代电路配置。能使高性能芯片获得较高的瞬态响应性能，满足负载要求。	形成成熟的 TLVR 系列产品线并进入行业领先水平。
5	铜铁共烧工艺一体成型功率电感	铜铁共烧工艺一体成型功率电感为全新工艺一体成型电感产品，在高饱和电流、高效率、小尺寸领域市场需求高，已于算力服务器高性能芯片 VRM 实现应用。拟基于铜铁共烧工艺持续开发前沿功率电感产品线，	搭建高度成熟的铜铁共烧工艺生产线，可实现客户各类前沿应用的多元化定制开发。

序号	项目	项目描述	项目拟达到目标
		其应用产品结构包括多相结构、耦合结构、模组化结构，对于提升公司在前沿高性能功率电感领域的竞争力具有重要意义。	
6	射频元件巴伦电感研发项目	巴伦电感是一种三端口无源射频器件，其本质是通过电感线圈的相互耦合实现的信号转换，作为射频电路中的关键元件，巴伦电感主要用于实现不平衡信号与平衡信号的转换，同时抑制共模噪声，在射频收发模块、天线系统、无线通信设备等场景中不可或缺。当前公司主营产品为功率电感，而公司网络设备类客户对射频电感有更高需求。为进一步满足网络设备类客户对于电感元件的多元需求，公司拟产品进行拓展迭代，结合功率电感的研发积淀，实现射频电感产品的市场开拓。	具备巴伦电感的研发制样及批量生产能力。
7	高频用低损耗复合粉配方及制备工艺研发项目	随着 VRM 整体迈向更高频率、追求更高功率密度和更快瞬态响应，功率电感的涡流损耗在高频下呈现指数级增长。为适应前沿 VRM 高频需求，拟通过粉料级配/复合探索，开发出成本相对较低的低损耗配方，可应用于冷压及热压工艺。	通过粉料加工工艺及配方改进，拟开发合理成本下的低损耗粉料配方，以应对持续提升的 VRM 工作频率。
8	一种用于模压电感的耐高温羰基粉末及制备方法研发项目	羰基铁粉的磁导率和饱和磁感应强度显著高于传统铁粉，高频应用中涡流损耗较低，但多数羰基化合物不耐高温，高温烘烤后材料性能下降，拟开发可用于高温环境（可达到 155°C）下高可靠性的羰基粉料配方及制备工艺，可广泛应用于汽车电子等新兴市场领域。	可用于高温环境下高可靠性的羰基粉料配方及制备工艺。
9	一种高磁导率电感用钝化液的开发及其粉末制备方法研发项目	基于软磁合金粉料需要做绝缘包覆处理，绝缘包覆处理下非磁性的绝缘层挤占了磁性材料的空间，并在磁路引入气隙，故磁导率一般不高，绝缘包覆又包括钝化和造粒两个步骤，钝化过程中常规的磷酸钝化虽能获得不错的绝缘效果，但磁导率降低明显。本项目拟开发出一种新的钝化液，在兼具绝缘/耐压良好的前提下，可以得到更高的磁导率，以用于前沿应用场景，此外高磁导率磁芯可以有效减少绕线圈数，降低绕线电阻和一体成型电感的铜损。	拟开发绝缘包覆钝化液配方，配制高磁导率粉料。

## (2) 研发费用投入情况

报告期内，公司研发费用及其构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,039.85	64.68%	882.68	65.17%	645.94	69.73%
直接投入	402.99	25.07%	323.25	23.87%	134.58	14.53%
折旧摊销费	97.08	6.04%	98.93	7.30%	104.65	11.30%

股份支付费用	20.06	1.25%	15.07	1.11%	-	0.00%
其他	47.58	2.96%	34.53	2.55%	41.21	4.45%
合计	<b>1,607.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,354.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>926.38</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司研发投入均为费用化支出，研发费用分别为 926.38 万元、1,354.45 万元和 1,607.56 万元，复合增长率为 31.73%。研发费用主要由职工薪酬、直接投入、折旧摊销费以及股份支付等构成。

报告期内，公司研发费用投入金额及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用	1,607.56	1,354.45	926.38
营业收入	34,038.06	25,795.49	19,345.28
研发费用率	4.72%	5.25%	4.79%

### (3) 研发人员情况

公司始终坚持研发驱动发展的理念，坚持不断加强研发团队建设，积极培养引进人才。截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员共计 77 人，占员工总人数的 10.53%。公司核心技术人员有 2 名，报告期内公司的核心技术人员没有发生变更。公司核心技术人员对公司研发的具体贡献如下：

核心技术人员	对公司研发的贡献
田林	作为公司研发与战略负责人，把握未来发展战略及研发方向，作为核心发明人申请多项发明专利；领导了公司研发团队进行前沿产业布局，长期深耕高性能芯片 VRM 模块应用；引导并培养了公司工程师文化并与行业下游头部厂商客户研发机构保持长期良好互动合作关系，持续进行前沿产品开拓。
武卫锋	作为公司总工程师，领导公司材料配方研发方向，深耕材料配方创新并与前沿工艺相适配，与研发团队共同完成多项关键技术创新，作为核心发明人申请多项发明专利。

公司通过提供优良的研发条件、搭建员工持股平台、约定保密协议和竞业禁止条款等多种方式，对核心技术人员进行激励和约束。公司核心技术人员均直接或间接持有公司股份。公司与核心技术人员签订了《劳动合同》及《保密协议》，对核心技术人员的合同期限、劳动报酬及保密义务进行了约定。报告期内公司核心技术人员保持稳定。

#### **(4) 研发制度及机制情况**

公司通过持续的研发投入逐步形成了技术和研发优势。公司技术创新机制主要包括：

##### **①前沿应用导向的研发机制**

公司已经建立一支研发经验丰富且具备创新才能的专业技术团队，能够准确把握行业前沿应用发展趋势并应对研发过程中的各项需求。公司坚持“了解与服务客户”的理念，依靠研发团队创新能力和对市场需求的及时把握，有针对性地对材料配方、生产工艺、结构设计等进行改进并推动产品迭代。

##### **②完善的研发体系和技术保护**

公司制定了完善的研发体系，在产品设计流程中从项目立项、实施、测试、验收及投产等方面制定了相关内控制度。同时公司高度重视研究成果，公司通过申请专利对知识产权进行技术保护，同时以签订保密协议和竞业禁止协议等多种措施防止核心技术泄密。

##### **③有效的激励机制**

为激励研发人员工作的积极性和主动性，公司建立了有效的薪酬和激励管理制度。公司鼓励研发人员加大力度推进新技术研发和产品研发，综合考虑了研发项目计划、岗位工作职责、个人综合能力、公司经营状况等因素后确定研发人员薪酬，以良好的薪酬激励水平提升其积极性；同时公司对部分优秀的研发骨干实施股权激励，确保研发骨干员工的个人利益与公司的长期利益相统一，增强员工归属感和责任感。未来公司将不断完善激励机制，进一步激发研发人员的创新精神。

##### **④完善的人才培养机制**

公司重视技术团队建设，在长期发展中形成并完善了技术人才的聘用、管理和培养制度。公司针对不同岗位职工，根据岗位需求建立了完善、成熟的培养机制和培训体系，以保证研发团队对行业发展趋势的敏感度。公司也对关键技术人才进行储备和培养，有计划地为公司提供优秀人才，保证公司的可持续发展。

**(四) 发行人的主要经营和财务数据及指标**

项目	2025年12月31日/2025年度	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额（万元）	33,788.97	25,380.51	21,752.63
归属于母公司所有者权益（万元）	17,749.40	12,248.13	9,182.48
资产负债率（母公司）	54.80%	51.55%	59.90%
营业收入（万元）	34,038.06	25,795.49	19,345.28
净利润（万元）	8,521.63	4,851.66	2,271.28
归属于母公司所有者的净利润（万元）	8,521.63	4,851.66	2,271.28
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	8,266.83	4,796.72	2,221.37
基本每股收益（元）	1.70	-	-
稀释每股收益（元）	1.70	-	-
加权平均净资产收益率	62.78%	41.94%	28.52%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	8,688.44	4,896.35	-258.94
现金分红（万元）	3,000.00	2,000.00	-
研发投入占营业收入的比例	4.72%	5.25%	4.79%

上述指标的计算公式如下：

(1) 资产负债率=负债总额/资产总额

(2) 加权平均净资产收益率=
$$\frac{P}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 基本每股收益=
$$P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 稀释每股收益=
$$\frac{P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})}{(S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})}$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

(5) 研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

## **(五) 发行人存在的主要风险**

### **1、技术和创新风险**

#### **(1) 技术与产品开发风险**

公司主要从事高特性功率电感元器件的研发、生产与销售，深耕高性能芯片核心供电模块（VRM）应用。近年来下游应用产品持续向性能更强、功率释放更高、形态更为轻薄方向发展，整机功率密度日益提升，高性能芯片 VRM 电路设计也日益复杂，对功率电感高效率、高饱和电流、高瞬态响应、高可靠性、小型化、薄型化、集成化等特性以及升级迭代的要求不断提高。若公司无法针对行业发展过程中出现的新形势、新要求进行合理的技术创新，公司可能面临技术创新失败的风险，进而不能持续开发出适应市场和客户需求的新产品，公司将面临产品保障能力和客户满意度下降的风险，进而影响盈利能力甚至持续发展。

#### **(2) 技术人才流失或储备不足的风险**

功率电感元器件的研发和生产覆盖电磁学、材料学、精密机械、电子测试、环境模拟实验等多个学科且需要长期的配方、工艺、结构设计方面的经验及数据积累，具备较高的技术门槛。如果公司无法为相关研发人员提供具备行业竞争力的薪酬待遇、激励机制和发展平台，持续吸引和稳定技术人才，则公司可能面临技术人才大量流失、人力储备不足的风险，进而对公司经营产生不利影响。

### **2、经营风险**

#### **(1) 客户相对集中的风险**

报告期内，公司前五大客户实现销售收入金额合计分别为 11,687.61 万元、16,339.02 万元和 20,869.58 万元，占营业收入的比例分别为 60.42%、63.34%和 61.31%，公司存在客户相对集中的风险。如果未来公司与下游市场主要客户合作出现不利变化、新客户拓展情况不达预期，或因行业竞争加剧、宏观经济波动等原因公司主要客户市场份额下降，可能导致主要下游客户减少对公司产品的采购

规模，从而对公司的业务发展带来不利影响。

## **(2) 主要原材料价格波动风险**

公司生产所需主要原材料包括粉料、磁芯、线材等材料。原材料价格的波动影响公司产品的成本及毛利率水平。原材料价格受宏观环境、经济周期、市场需求等因素的影响可能出现波动。如若原材料市场价格出现大幅上涨或公司难以将原材料价格上涨传导至下游客户，可能导致公司营业成本上升，从而对公司业绩产生不利影响。

## **3、管理及内控风险**

### **(1) 实际控制人控制风险**

公司实际控制人为田林、李翠娟。截至招股说明书签署日，田林直接持有公司 47.00% 股份，通过新余盛盈、深圳弘胜合计控制公司 10.50% 股份，李翠娟直接持有公司 10.00% 股份，田林、李翠娟合计控制公司 67.50% 股份。公司实际控制人若利用其控制地位优势，通过行使表决权或其他方式对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、财务决策和利润分配等方面施加重大影响，则存在实际控制人利用其控制地位损害公司和其他中小股东利益的风险。

### **(2) 快速发展引致的管理及经营风险**

本次发行后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。同时经营规模的快速增长也给公司建立适应现代企业制度所需要的管理体系、制度以及建立有效的激励和约束机制带来了一定的压力。

## **4、财务与税收风险**

### **(1) 应收账款规模较大的风险**

报告期各期末，公司应收账款和应收票据账面价值分别为 8,564.97 万元、10,306.03 万元和 13,905.52 万元，占资产总额的比例分别为 39.37%、40.61% 和 41.15%，占比较高。伴随报告期内业务规模不断扩大，公司应收账款规模也相应

增长。如果公司主要客户出现经营状况和财务状况恶化、无法按期付款的情况，则存在应收账款出现逾期或无法收回的可能，从而给公司带来坏账损失。

## **(2) 毛利率下降的风险**

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 33.19%、39.55% 和 44.49%，毛利率水平较高。未来若由于市场竞争、客户变动、汇率波动、公司研发能力无法跟进技术发展步伐等因素使公司产品毛利率下降，若公司不能采取有效措施抵消上述不利因素影响，则公司将存在毛利率下降的风险。

## **5、宏观经济波动和市场环境变化风险**

公司产品下游行业和宏观经济周期具有较强的关联性，其景气状况会随着宏观经济周期出现波动。如果全球宏观经济环境、居民消费水平或者下游基础设施建设发生较大不利变化从而导致下游市场需求有所下降，则将对公司所处功率电感元器件行业造成不利影响，进而可能对公司的经营业绩造成不利影响。

## **6、市场竞争加剧风险**

随着高性能芯片 VRM 模块的创新发展，功率电感元器件的市场前景将更加广阔，可能导致潜在竞争者的加入和原有企业的扩张并将进一步导致市场竞争加剧。如果公司不能持续提高研发与技术工艺能力，保证产品性能、品质与良率处于行业前沿水平，将会面临不利的市场竞争局面，盈利能力和财务状况将受到一定程度的不利影响。

## **7、募集资金投资项目实施效果无法达到预期的风险**

若未来项目实施过程中相关因素发生重大不利变化，如宏观经济及应用环境发生重大变化或企业自身管理能力无法适应等，可能导致本次募集资金投资项目新增的产能无法得到有效消化，亦可能出现项目不能如期完成或不能实现预期收益等不利情形，进而影响公司的盈利能力。

## **8、发行失败的风险**

公司股票的市场价格不仅取决于公司的经营业绩和发展前景，宏观经济形势变化、国家经济政策的调控、利率水平、汇率水平、投资者预期变化等各种因素

均可能对股票市场带来影响，进而影响投资者对公司股票的价值判断。因此，本次发行存在由于发行认购不足或未能达到上市条件而发行失败的风险。

## 二、本次证券发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股份数量	不超过 1,666.6667 万股	占发行后总股本比例	25.00%
其中：发行新股数量	不超过 1,666.6667 万股	占发行后总股本比例	25.00%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 6,666.6667 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（每股收益按照【】年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	【】元（按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益加新股发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	【】元（按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会及深交所认可的其他发行方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在深交所开立创业板股票交易账户的自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、规章及规范性文件禁止认购的除外）或中国证监会、深交所规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	高端一体成型电感智能生产基地建设项目		
	研发中心建设项目		

	数字化智能化升级项目
	补充流动资金项目
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，包括：保荐及承销费【】万元、审计及验资费【】万元、评估费【】万元、律师费【】万元、发行手续费及其他费用【】万元
高级管理人员、员工参与战略配售情况	【】
保荐人相关子公司参与战略配售情况	【】
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用

### 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况

#### （一）本次证券发行上市的保荐代表人情况

刘俊清，保荐代表人，曾负责或参与泰鸿万立（603210）、志高机械（920101）、光大同创（301387）、浙江自然（605080）、海晨股份（300873）、联得装备（300545）、天成自控（603085）、恒华科技（300365）、陕西煤业（601225）等多个 IPO 项目，拥有丰富的投资银行业务经验。

郑睿，保荐代表人、注册会计师，清华大学学士、硕士，曾担任泰鸿万立（603210）、志高机械（920101）、光大同创（301387）、浙江自然（605080）、海晨股份（300873）、万胜智能（300882）、顶点软件（603383）、联得装备（300545）、天成自控（603085）、恒华科技（300365）等多个 A 股 IPO 项目的负责人或保荐代表人，拥有丰富的投资银行业务经验。

#### （二）本次证券发行上市的协办人情况

刘涛，保荐代表人、注册会计师，先后参与浙江自然（605080）、光大同创（301387）等 IPO 项目以及联得装备（300545）2021 年向特定对象发行股票等多个再融资项目，具有较为丰富的投资银行项目执行经验。

#### （三）项目组其他成员情况

本次发行项目组的其他成员：朱鸿润、韩天奕、马赫遥、罗时道、杜俊涛。

#### 四、发行人与保荐人的关联关系

##### **（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况**

截至本上市保荐书签署日，本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

##### **（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况**

截至本上市保荐书签署日，发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有、控制保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

##### **（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况**

截至本上市保荐书签署日，本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

##### **（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况**

截至本上市保荐书签署日，本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

##### **（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系**

截至本上市保荐书签署日，本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

## 第二节 保荐机构的承诺事项

一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

本保荐机构同意推荐发行人证券发行上市，并具备相应的保荐工作底稿支持。

二、本保荐机构自愿接受深圳证券交易所的自律监管。

## 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见

### 一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论

本保荐机构认为：发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。本保荐机构愿意推荐发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

### 二、本次证券发行上市所履行的程序

#### （一）发行人董事会审议通过

2026年3月6日，发行人召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》《关于公司首次公开发行股票并上市后36个月内稳定股价预案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

#### （二）发行人股东会审议通过

2026年3月23日，发行人召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》《关于公司首次公开发行股票并上市后36个月内稳定股价预案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

#### （三）本次发行取得批复情况

本次发行不存在需要取得国资委、国防科工局等外部审批的情况。

#### （四）发行人决策程序的合规性核查结论

本保荐机构认为，发行人本次发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序。

### 三、发行人符合板块定位及国家产业政策的核查情况

#### （一）发行人符合创业板定位

##### 1、公司所属行业符合创业板行业领域

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类之“C3981 电阻电容电感元件制造”小类。

发行人主营业务不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业，也不属于禁止产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。

##### 2、公司符合创业板定位相关指标

公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条中第一套标准，具体情况如下：

创业板定位相关指标一	是否符合	公司指标情况
最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年投入金额不低于 1,000 万元	是	最近三年即 2023 年度、2024 年度、2025 年度，公司研发投入金额分别为 926.38 万元、1,354.45 万元和 1,607.56 万元，复合增长率为 31.73%且最近一年金额不低于 1,000 万元
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%，最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。	是	最近一年即 2025 年度，公司营业收入为 34,038.06 万元、超过 3 亿元。

##### 3、发行人符合创业板定位的具体说明

###### （1）公司能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展

公司主要从事高特性功率电感元器件的研发、生产与销售，深耕高性能芯片

核心供电模块（VRM）应用，向全球知名品牌商、制造服务商提供具有高效率、低损耗、高饱和电流、高瞬态响应、高可靠性、小型化、薄型化、集成化等特性的功率电感产品解决方案。公司主营高特性功率电感为VRM模块的关键元器件，其核心作用包括能量传递、电流平滑续流、抑制电流突变/尖峰、降低纹波与噪声等，以充分满足高性能芯片超低压、大电流、高瞬态等供电要求，其质量和特性直接关系到VRM电路的效率、电压稳定性、瞬态响应能力及可靠性，直接影响高性能芯片的性能释放、响应效率与工作稳定性，并对整机的效能和稳定性产生重要影响，已成为支撑高性能芯片稳定高效运行的“隐形基石”。公司主要产品需要面对高效率、低损耗、高饱和电流、高瞬态响应、高可靠性、小型化、薄型化、集成化等核心需求并深度定制，具有较高的技术壁垒和应用特异性，与其他电力电子产品相关模块的功率电感产品存在明显差异。

经过长期耕耘和发展，公司在材料配方、生产工艺、结构设计等领域拥有了较强的研发创新能力，能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展。

## （2）公司具备较强的技术创新性

近年来，高性能芯片VRM持续朝向更大功率、更大电流、更高功率密度、更高瞬态响应能力方向演进。一方面，该演进特点决定了功率电感厂商必须持续进行材料配方改进、创新工艺开发，以实现更小的尺寸、更高的饱和电流及更低的损耗；另一方面，前沿VRM的高度集成设计、垂直供电设计、耦合电路设计等创新助推功率电感结构设计持续创新，涌现了多相结构功率电感、模组化结构功率电感、形式多样的耦合结构功率电感和TLVR功率电感等新产品。VRM功率电感发展迭代深度契合高性能芯片VRM的演进路径，始终处于功率电感行业的前沿。

公司紧跟行业前沿发展趋势和方向，持续加大研发投入并进行材料配方、生产工艺、结构设计等方面创新，形成了较为显著的创新成果。截至2025年12月31日，公司已取得专利105项，其中发明专利17项并拥有一系列核心技术。

软磁材料配方创新方面，粉料选型与复合、粒径级配、绝缘包覆、粘结与润滑为一体成型功率电感软磁复合材料的制备部分，直接关系到一体成型功率电感的性能指标。经过多年研发探索，公司已形成羰基铁粉、铁硅粉/铁硅铬粉、

铁镍粉、非晶/纳米晶粉等多元粉料应用体系，已成功开发多种材质及不同磁导率适用的粉料复合配方，持续开发与不同粉料配方及热压、铜铁共烧等前沿工艺相适配的绝缘包覆技术。通过软磁材料配方创新，公司掌握了“粉末颗粒级配技术”、“粉末造粒技术”、“粉末表面处理技术”、“粉体绝缘技术”等多项关键核心技术，软磁材料配方具有成型密度高、可塑性好、综合性能优异等良好特性。

生产工艺创新方面，公司持续进行前沿工艺开发并专注于工艺创新，近年来已形成一体成型冷压工艺、热压工艺、铜铁共烧工艺等技术阶梯体系并掌握多项核心技术。通过阶梯式的工艺开发，公司对软磁材料微观结构控制能力持续深化，功率电感产品特性沿着更高成型密度、更高磁导率、更高效率、更高饱和电流、更小尺寸等方向攀升。

结构设计创新方面，为应对近年来高集成、高功耗发展趋势的挑战，致力于VRM模块的功率电感厂商在产业链中的定位已经从单纯的元器件供应商演变为产业链中“协同开发”的战略合作伙伴。公司积极加大产品结构创新的投入力度，结合前沿高性能芯片VRM模块的高度集成设计、垂直供电设计、耦合电路设计等创新，于AI PC小型化功率电感、多相结构功率电感、模组化结构功率电感、耦合结构功率电感、TLVR功率电感等领域开展创新设计与生产实践，充分实现高效率低损耗、高饱和电流、高瞬态响应、高可靠性、小型化、薄型化、集成化且部分产品已实现量产供应，公司具备前沿方向功率电感产品的研发创新及交付能力。

### **(3) 公司具有较强的市场竞争力，所处行业市场前景广阔，具有成长性**

根据QYResearch相关数据，2025年功率电感行业整体规模达362.04亿元并将在2032年达到842.24亿元，2025年至2032年复合增长率约为12.82%，诸多新兴领域的发展推动行业市场规模持续扩大、行业快速增长。

受产业发展历史、技术及行业经验积累沉淀、技术及市场壁垒等多因素影响，功率电感元器件行业的头部企业主要集中在日本及中国台湾地区，上述企业历史发展较为悠久、技术及资金实力雄厚，在全球范围内占据较高的市场份额。公司已经拥有较强的技术实力及较高的市场地位，已与计算机、算力服务器、网络设

备、智能安防、工业控制等领域知名客户建立良好合作关系并已积极布局汽车电子、具身智能等新兴市场方向，具备较强的行业与市场开拓能力。

综上所述，公司能够通过自身的创新、创造、创意促进新质生产力发展，符合创业板所属行业和相关财务指标的要求，具备良好的成长性，符合创业板定位。

## **（二）发行人符合国家产业政策**

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。公司所处行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年修订）》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板上市的行业或禁止类行业。

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励类的第二十八大类“信息产业”中的第5小类为“新型电子元器件制造”包含“片式元器件”产品。公司所产功率电感为《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类“片式元器件”产品。

发行人产品符合产业政策和国家经济发展战略。

## **（三）核查程序及核查结论**

### **1、核查程序**

（1）访谈发行人总经理、财务负责人及核心技术人员等主要人员，现场考察发行人生产经营场所，走访发行人主要客户、供应商，了解发行人的主要经营模式、主要产品情况、核心技术情况、研发创新情况；

（2）获取并查阅发行人研发项目情况、发行人拥有的知识产权情况、发行人享有的资质及荣誉等情况，了解发行人核心技术及产品创新性；

（3）查阅《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）、《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）等相关规则，结合发行人主营业务、主要产品等特征判断发行人所属行业；

（4）查阅发行人所处行业研究和市场分析报告、同行业可比公司的公开资料，了解近年来发行人所处行业发展状况、市场竞争格局以及发行人的经营模式、

技术及产品竞争力、市场地位等情况，判断发行人生产经营是否符合国家产业政策；

(5) 查阅发行人经审计的财务报表及审计报告，获取报告期内研发投入明细，分析研发投入构成及其合理性，核查研发费用核算的合理性和准确性；

(6) 比照《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年修订）》相关规定，判断发行人财务指标是否满足创业板定位相关指标要求；

(7) 获取发行人报告期内的收入成本明细表，对销售收入按照产品类别、销售数量、销售单价、客户等多个维度进行分析，了解发行人业绩增长情况，结合行业发展趋势和市场竞争格局，分析判断发行人的成长性及可持续性。

## 2、核查结论

经核查，保荐人认为：

发行人自身具有创新、创造、创意特征，不断进行材料配方、生产工艺、产品结构等方面的创新；发行人所属的电阻电容电感元件制造行业是国家鼓励、扶持的产业，具备较大增长潜力；报告期内发行人经营业绩持续增长、未来成长性良好；发行人不属于原则上不支持申报在创业板发行上市的行业范围内，符合《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年修订）》等法律、法规或规范性文件的要求，发行人符合创业板板块定位及国家产业政策。

## 四、本次发行符合上市条件

保荐机构依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），对发行人是否符合《股票上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查，核查意见如下：

### **（一）发行人符合《股票上市规则》之“（一）符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业板发行条件”**

保荐机构对发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市是否符合《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）规定的发行条件

进行了逐项核查，结果如下：

### 1、发行人符合《首发管理办法》第十条的规定

保荐机构查验了发行人工商档案、《发起人协议》、发行人的公司章程，股东会、董事会会议文件和内部制度文件。发行人前身艺感科技有限公司成立于2007年12月2日，成立时注册资本为50.00万元，田林与李翠娟以货币方式出资。2025年5月10日，经艺感科技有限公司股东会决议通过，发行人依法整体变更为深圳市艺感科技股份有限公司。自艺感科技有限公司成立之日起，发行人已经持续经营三年以上，是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。发行人已经依法建立健全股东会、董事会及下属各专门委员会，拟定独立董事、董事会秘书工作制度，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

### 2、发行人符合《首发管理办法》第十一条的规定

保荐机构查阅了发行人的相关财务管理制度，确认发行人会计基础工作规范。项目组查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的发行人最近三年标准无保留意见的审计报告，查阅了发行人重要会计科目明细账、抽查了相关凭证。发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，符合《首发管理办法》第十一条第一款的规定。

保荐机构查阅了发行人的内部控制制度，访谈了发行人的董事、高级管理人员，查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留结论的内部控制审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，符合《首发管理办法》第十一条第二款的规定。

### 3、发行人符合《首发管理办法》第十二条的规定

经查验发行人资产权属证书、审计及财务报告、组织机构和职能部门设置情况、内部制度、控股股东及实际控制人控制企业的企业法人营业执照、工商资料、财务报告、银行账户流水等资料，根据发行人相关陈述并同发行人高级管理人员进行访谈，确认发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《首发管理办法》第十二条第一款的规定。

经查验发行人企业法人营业执照、公司章程、股东会、董事会会议文件、财务报告等，确认发行人最近二年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大不利变化。经查验发行人的工商资料、历次股权变更的协议等文件并同相关人员进行访谈，确认发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年实际控制人没有发生变更。符合《首发管理办法》第十二条第二款的规定。

经查验发行人的商标证书、专利证书、软件著作权证书等主要资产权属证书，查验发行人审计报告、财务报告、银行账户流水、企业信用报告、全国法院被执行人信息公开网和中国裁判文书网并根据发行人陈述，确认发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷、重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项。经查验发行人所属行业的行业研究报告、行业规划、相关产业政策并经走访发行人主要客户和供应商，确认发行人不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。符合《首发管理办法》第十二条第三款的规定。

#### **4、发行人符合《首发管理办法》第十三条的规定**

保荐机构查阅了发行人章程、查阅了所属行业相关法律法规和国家产业政策，访谈了发行人高级管理人员，实地查看了发行人生产经营场所，查阅了发行人的经营范围，该等经营范围已经主管工商部门核准并备案。发行人的生产经营活动符合法律、行政法规和发行人章程的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十三条第一款的规定。

保荐机构查阅了发行人实际控制人出具的调查表，查看了相关部门出具的发行人、控股股东、实际控制人的信用报告、无犯罪记录证明并进行了网络检索，确认发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康

安全等领域的重大违法行为，符合《首发管理办法》第十三条第二款的规定。

保荐机构查阅了发行人董事、高级管理人员出具的调查表，对董事、高级管理人员进行了访谈并进行了网络检索，确认发行人的董事、高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《首发管理办法》第十三条第三款的规定。

综上所述，本次发行符合《首发管理办法》规定的发行条件。

## **(二) 发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元**

发行人本次发行前股本总额为 5,000.00 万元，公司本次拟公开发行股票不超过 1,666.6667 万股，发行人股本总额不低于 3,000 万元，符合《上市规则》2.1.1 第二款的规定。

## **(三) 公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上**

公司本次发行前股本总额为 5,000.00 万元，公司本次拟公开发行股票不超过 1,666.6667 万股，公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25%，符合《上市规则》2.1.1 第三款的规定。

## **(四) 财务指标符合《上市规则》规定的标准**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第二章 2.1.2 中第（一）条规定：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2026]518Z0012 号），发行人 2024 年度和 2025 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 4,796.72 万元和 8,266.83 万元，累计达到 13,063.55 万元。发行人最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元，符合上述上市标准。发行人不是红筹企业，不存在表决权差异安排。

经逐项核查，本保荐机构认为，发行人符合《证券法》、《注册管理办法》及《上市规则》规定的公开发行股票并在创业板上市的条件。

## 五、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

事项	安排
(一) 持续督导事项	在本次发行结束当年的剩余时间以及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，协助发行人制订、执行有关制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	协助和督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易本保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定，适时审阅发行人信息披露文件。
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	建立与发行人信息沟通渠道，根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施，定期对项目进展情况进行跟踪和督促。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐机构进行事前沟通。
(二) 保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作；有充分理由确信发行人或相关当事人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，应督促发行人或相关当事人做出说明并限期纠正，情节严重的，应当向中国证监会、交易所报告；可要求发行人或相关当事人按照法律、行政法规、规章、交易所规则以及协议约定方式，及时通报信息；可列席发行人或相关当事人股东会、董事会等有关会议；按照中国证监会、交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	发行人协调相关当事人配合保荐机构的保荐工作，并督促其聘请的其他证券服务机构协助保荐机构做好保荐工作。
(四) 其他安排	无。

## 六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

保荐代表人：刘俊清、郑睿

联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

邮编：510627

电话：020-66338888

传真：020-87553600

## 七、保荐机构认为应当说明的其他事项

本保荐机构不存在应当说明的其他事项。

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于深圳市艺感科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人:

刘涛

刘涛

保荐代表人:

刘俊清

刘俊清

郑睿

郑睿

内核负责人:

崔舟航

崔舟航

保荐业务负责人:

胡金泉

胡金泉

保荐机构总经理:

秦力

秦力

保荐机构法定代表人、董事长:

林传辉

林传辉



广发证券股份有限公司

2026年5月15日